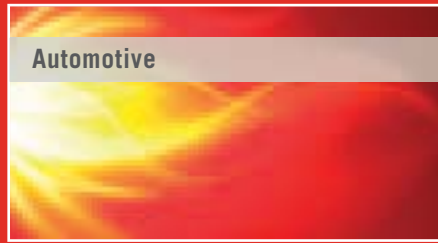




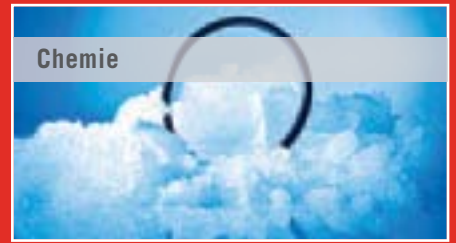
**Flüssigdichtungen:
Bekannt genug?**

10



**Es wird immer heißer
für Dichtungen**

14



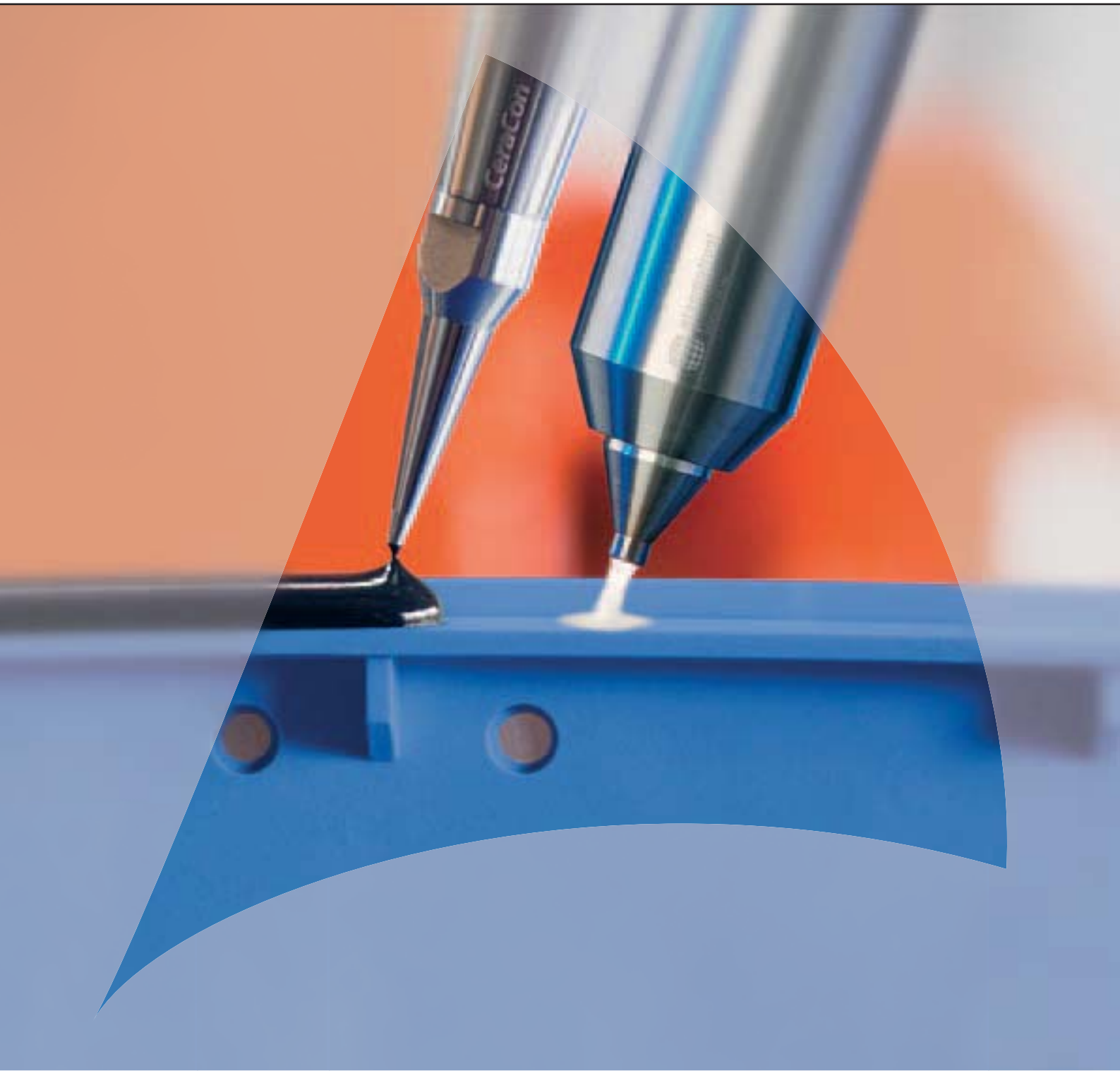
**Extremtemperaturen:
Kaum Limits**

30

D I C H T !

TRIALOG DER DICHTUNGS- UND KLEBETECHNIK

04-2012 | € 8,50



Praxiswissen

Von Praktikern für Praktiker

3. VPCM (Vessel Pipe-Connection-Meeting) am **01.02.2013** in Hamburg. Veranstalter: Lorenz Kommunikation

Oberflächenveredelung für industriell genutzte Elastomere am **27.02.2013** in Mannheim: Veranstalter ISGATEC GmbH

Dichtungen und Konstruktionselemente aus PTFE am **28.02.2013** in Mannheim: Veranstalter ISGATEC GmbH

Silikon – ein Werkstoff fast ohne Grenzen; Eigenschaften, Verarbeitungsformen, Techniken und Anwendungsbereiche am **05.03.2013** in Mannheim: Veranstalter ISGATEC GmbH

Vertragliche Gestaltung und Überprüfung von Qualitätssicherungsvereinbarungen am **06.03.2013** in Mannheim: Veranstalter ISGATEC GmbH

TPE – Thermoplastische Elastomere: innovative Werkstoffe formen die Zukunft am **07.03.2013** in Mannheim: Veranstalter ISGATEC GmbH

Geschäumte Elastomere und Schaumkunststoffe am **12.03.2013** in Mannheim: Veranstalter ISGATEC GmbH

Gleitringdichtungen und Wellenlippen-dichtungen – Technik, Werkstoffe und Anwendungen am **13.03.2013** in Mannheim: Veranstalter ISGATEC GmbH

O-Ring Dichtungen – Auslegung, Einsatzgrenzen und Anwendungen vom **12. bis 13.03.2013** in Oberstenfeld: Veranstalter: O-Ring-Prüflabor Richter

Einkauf/Vertrieb: Technische Zeichnungen nach aktuellen Normen überprüfen und Rechtssicherheit erreichen vom **17. bis 18.04.2013** in Mannheim: Veranstalter ISGATEC GmbH

Schadensanalyse von elastomeren Dichtungen vom **16. bis 17.04.2013** in Oberstenfeld: Veranstalter: O-Ring-Prüflabor Richter

www.isgatec.com

www.lorenz-kommunikation.de

www.o-ring-prueflabor.de



Zeit sparen...

...mit neuer Dispensertechnologie

BE- UND VERARBEITUNG – Die neue Dos.Flex-Baureihe zählt mit seinen Linearmotorenachsen und einer Verfahrgeschwindigkeit von 1.000 mm/s bei 0,02 mm Positioniergenauigkeit zu den schnellsten Dosieranlagen auf dem Dispensermarkt. Die Systeme wurden mit der Zielsetzung entwickelt, Dosiernebenzeiten, Handling- und Rüstzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Sie sind flexibel aufgebaut und können in kurzer Zeit umgerüstet werden. Die Anlagen sind sowohl als Stand-Alone-, halbautomatisierte oder vollautomatisierte Systeme lieferbar. Umfangreiches und komfortables Zubehör, auch nachrüstbar, sorgt für hohe Flexibilität und Vielseitigkeit. Durch die schnellen Verfahrgeschwindigkeiten kann der Prozess über AOI-Systeme überwacht werden und Dosierdaten und Parameter für das Traceability können sofort verarbeitet und weitergegeben werden.



Gut zu wissen:

- Aufgrund der hohen Flexibilität und verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich die Baureihe einfach an die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen anpassen

Kübler GmbH

www.dosiertechneik-kuebler.de



Neue Plasmafunktionalisierung...

...eröffnet neue Werkstoffeigenschaften

BE- UND VERARBEITUNG – Mit Hilfe der Plasmatechnologie lassen sich nicht nur Oberflächen von Kunststoffbauteilen, sondern auch von Polymerpartikeln modifizieren. Damit können z.B. funktionale hydrophobe Additive dauerhaft hydrophil gemacht werden – mit dem Effekt verbesserter Produkteigenschaften für innovative Anwendungen. Diener electronic hat für diesen Einsatzzweck eine Niederdruck-Plasmaanlage entwickelt, in der pro Charge bis zu 25 kg Granulat oder Mikropulver effizient behandelt werden können. Eine gängige Plasmaanwendung des Hersteller ist heute die Hydrophobierung der Pulver. In der PC-gesteuerten Anlage können pro Charge 25 kg Pulver durch die Zuführung von Sauerstoff, Stickstoff oder Argon als Prozessgase hydrophiliert werden. Bislang war die Plasmabehandlung von Schüttgütern wie Pulver nur im Labormaßstab mit Mengen bis zu 1 kg möglich. Das Pulver wird während des gesamten Prozesses – der je nach Korngröße des Pulvers oder Granulats zwischen 30 min und mehreren Stunden dauert – in einem Trommelrezipienten kontinuierlich durchmischt, sodass eine gleichmäßige Behandlung gewährleistet ist. Durch die niedrigen Prozesstemperaturen von rd. 30 °C ist die thermische Schädigung des Pulvers ausgeschlossen, sodass deren Grundeigenschaften unverändert bleiben. Die Einstellung der gewünschten Oberflächeneigenschaften wird durch die Variation der Prozessparameter gezielt gesteuert. Alle prozessrelevanten Daten werden über die Software gesteuert und überprüft. Zudem ermöglicht sie eine Chargenrückverfolgbarkeit durch das Erstellen von Protokollausdrucken und Etiketten. Die Wirksamkeit der Behandlung wird mittels der Kontaktwinkelmessungen überprüft. Dabei wird der Randwinkel eines Wassertropfens zur aktivierten Oberfläche gemessen. Je besser die Aktivierung ist, desto flacher liegt der Wassertropfen auf der Oberfläche.

Gut zu wissen:

- Mit der Anlage sind die Voraussetzungen für einen industriellen Einsatz geschaffen

Diener electronic GmbH + Co. KG

www.plasma.de

